

Produktbeschreibung

Finish: dieses Board wird nach IPC-6012.
Stärke ist. 050uM über 3-6uM Nickel.

Copper Plate holes Minimum .025 AVG, .020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden

Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte Indikator-Karte auf der Oberseite

Layer-Struktur

L1-----hoz

-PP 7Mil-

--

L2-----1oz.

-COre 9.05 MIL-

L3-----1oz

--

-PP 7mil-

L4---hoz-----

Layer-Definitionen:

*. GCMT-Top Conformal Coating Mask

*. GTP-Top Löten

*. GTO-Top Siebdruck

*. GTS-Top Soldermask

*. GTL-oberste Schicht

*. G2L-innere Signal Schicht 1

=====

*. G3L-innere Signal Schicht 2

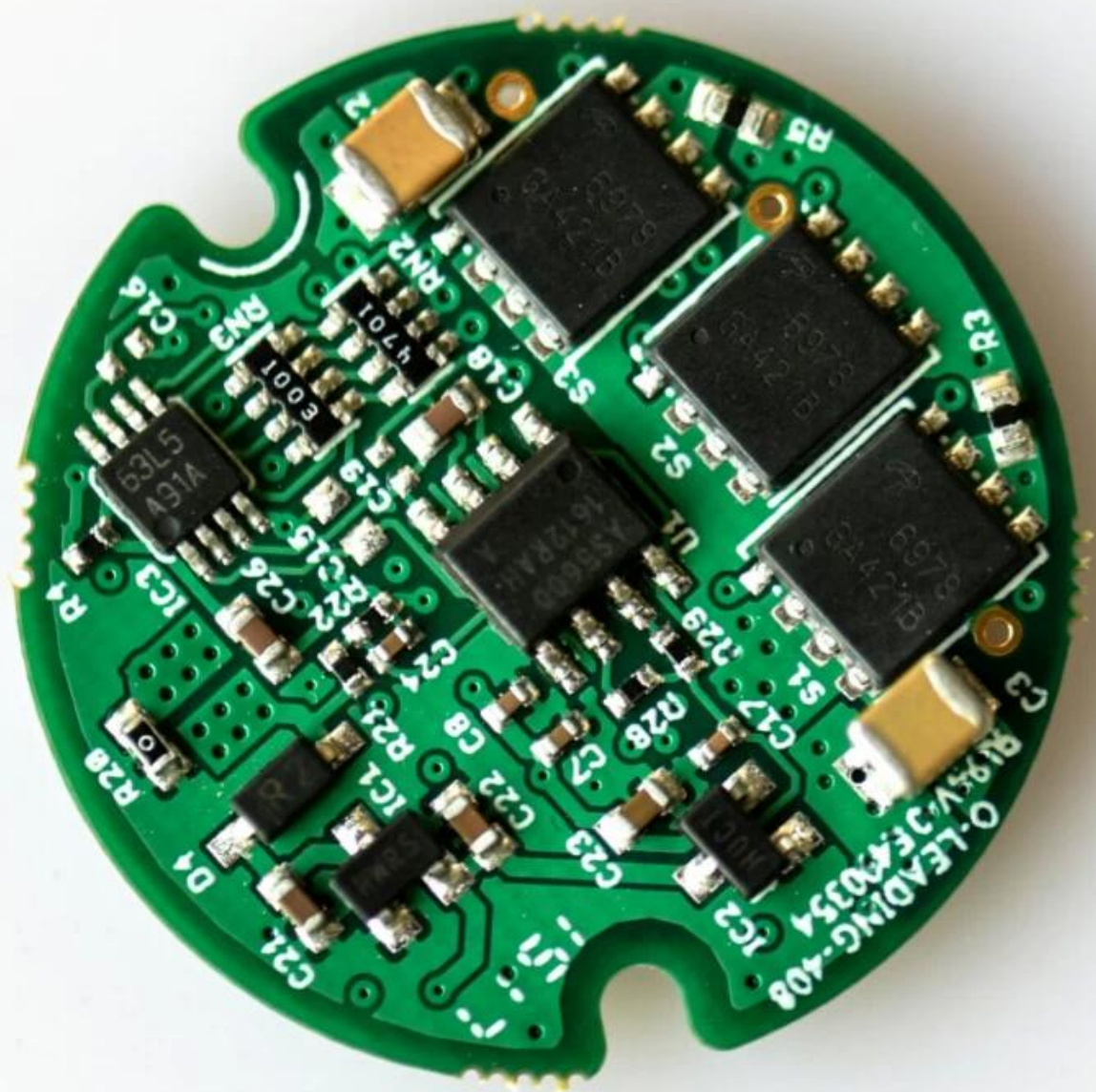
*. GBL-Bottom-Layer

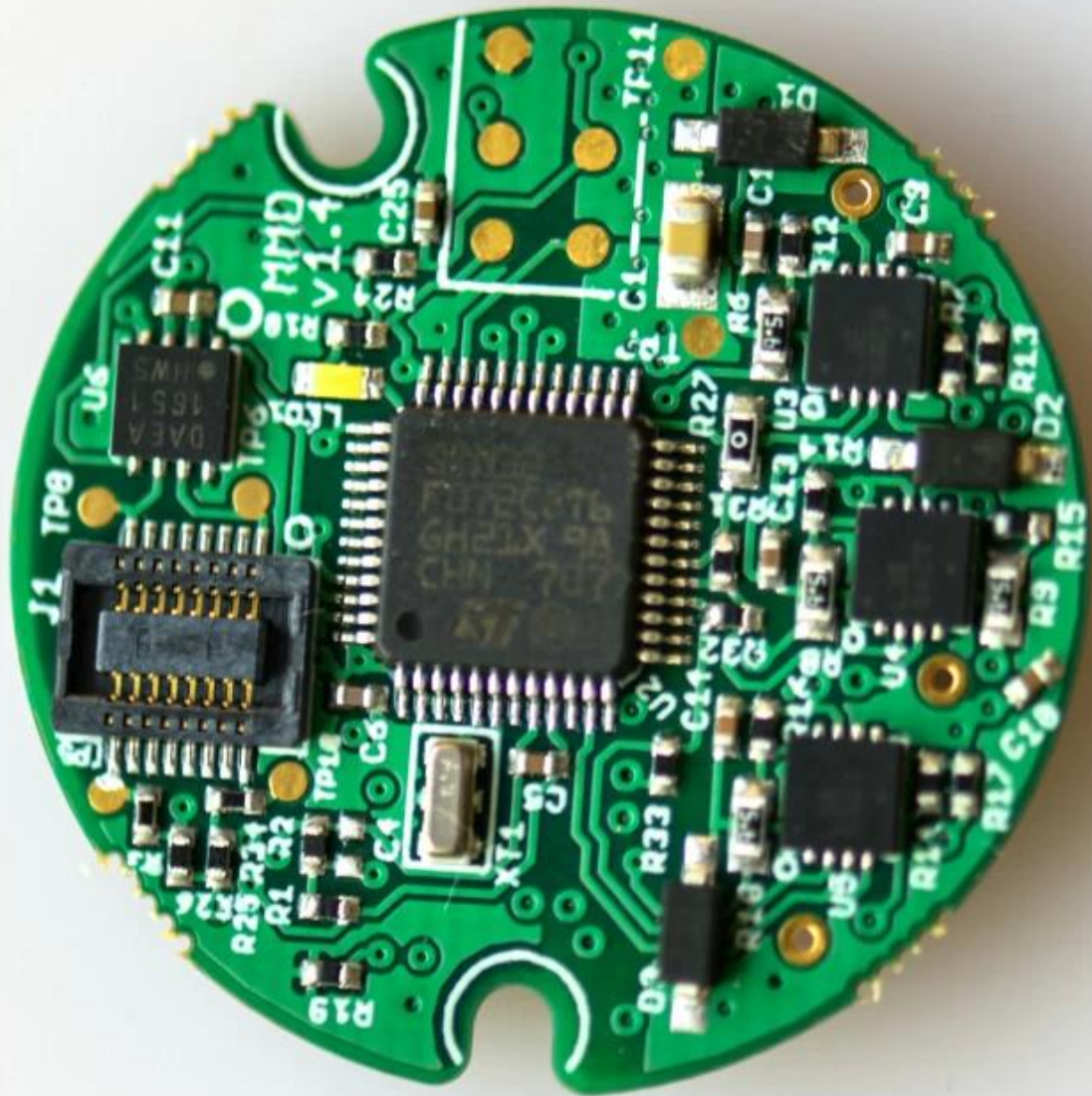
*. GBS-Bottom Soldermask

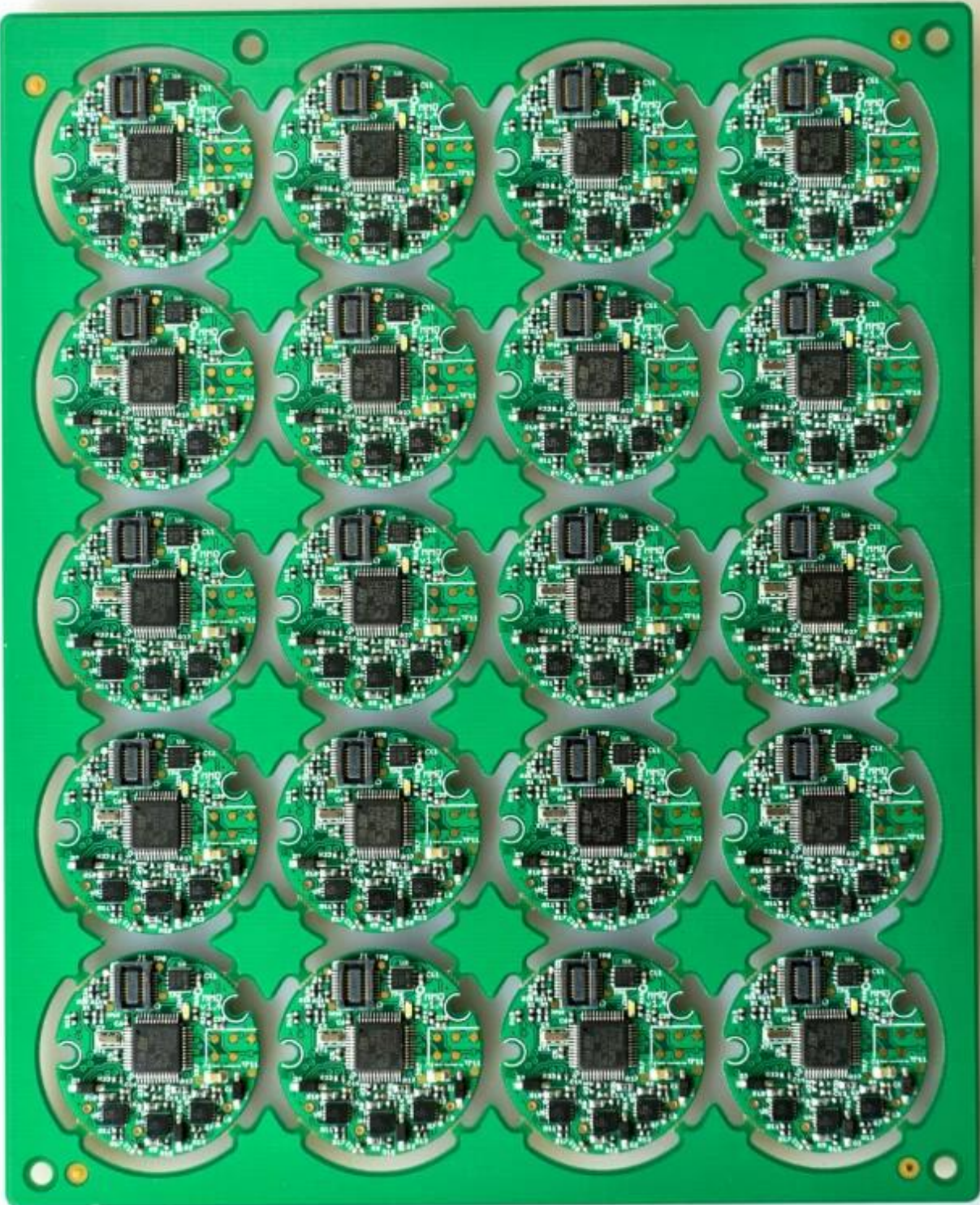
*. GBO-Bottom Siebdruck

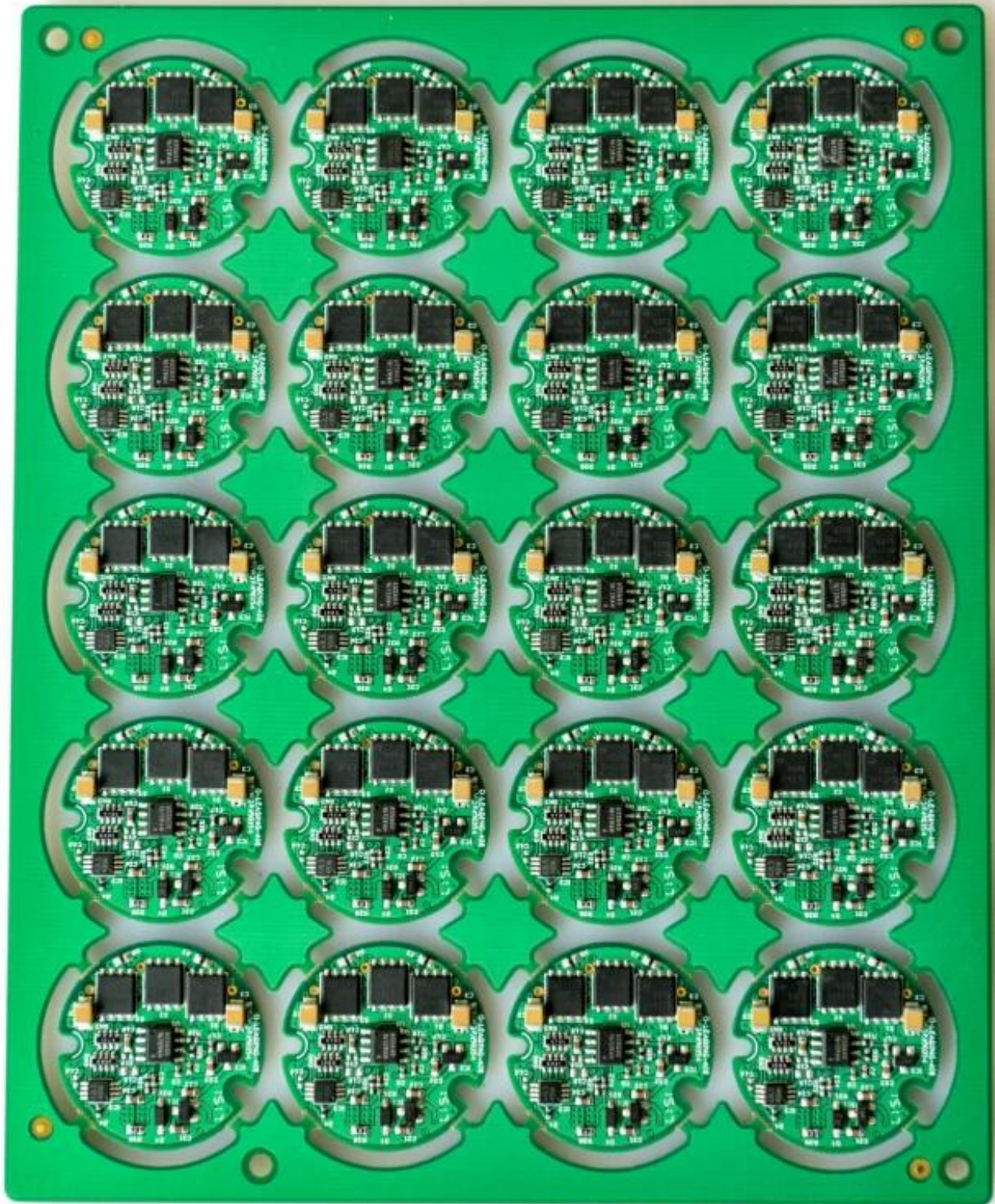
*. GBP-Bottom Lot Paste

*. GCMB Beschichtung Maske









[Quick Turn PCB Printed Circuit Board, HDI PCB Printed Circuit Board, Gedruckte Platine](#)